

アプライド・マテリアルズ (AMAT)

前年比増収増益・配当と自社株買い強化。HBM3 需要により DRAM 関連成長。ファウンドリ・ロジック関連は後半から復調、今後本格化の兆し。

ナスダック | 半導体製造 | 業績フォロー

BLOOMBERG AMAT:US | REUTERS AMAT.OQ

直近業績：11月14日発表の2024年10月期通期業績は、売上高が前年比2.5%増の271億USD、営業利益が同2.8%増、当期純利益が同4.7%増の71億USDの増収増益。製造・販管コスト効率化により対前年比で利益率改善。4Q業績では売上高が前年同期比4.8%増も当期利益が同13.6%減。フリーキャッシュフロー低下も、増配・自社株買い増額により株主還元は強化された。

事業展開・戦略：中国向けの通期売上は前年比で40%増、22年から年平均18.1%成長した。これは24年上半期までに見られた対中輸出規制強化前の駆け込み需要が影響したものであるため、24年3Qからは鈍化し、24年4Q売上では前年割れとなった。一方、4Q23年から低迷していた台湾向け売上は、24年下半期にかけて回復。韓国向け売上にも同様の傾向が見られた。

主要セグメントの半導体システムの通期売上は対前年比で横ばい。同セグメントのDRAM（揮発性メモリ）関連の通期売上は対前年比で68%増、22年から年平均25%成長と大きく伸ばした。ファウンドリ・ロジック関連売上は通期では前年割れも、4Qでは前年同期比12%増で復調した。

投資論点・リスク：AIにより高性能化が要求される先端半導体製造の技術焦点は、おおまかに「微細化」と「パッケージング高度化」の2点であり、後者はシリコンダムの配置・配線の集積度を高める技術である。アプライド・マテリアルズ社は広帯域高速メモリ（HBM）の積層パッケージング技術、SoC（組み込みチップ）の三次元積層技術であるHI（ヘテロジニアス・インテグレーション）、SoCの配線・電力効率化を担うGAA（ゲート・オール・アラウンド）型パッケージング技術を提供する。

24年10月期通期のDRAM関連の伸びはHBM3という最新規格の広帯域高速メモリ需要に牽引された。解析・機械学習には特徴量（features）が増える毎に必要なメモリ量が加速的に増加する「次元の呪い」という問題が存在するため、AIの浸透によりDRAM関連は堅調な推移が見込まれる。今後、AIの重点が推論やエッジに移ることによりHIやGAAソリューション需要が本格化し、ロジック関連売上や台湾（TSMC）向け売上は成長軌道に回帰することが見込まれるだろう。

四半期業績	4Q23	3Q24	4Q24	ΔY/Y	1Q25(F)
売上高 (百万USD)	6,723	6,778	7,045	4.8%	7150
当期利益 (百万USD)	2,004	1,705	1,731	-13.6%	--
希薄化後EPS (USD)	2.38	2.05	2.09	-12.2%	2.29
四半期配当 (USD)	0.32	0.40	0.40	25.0%	0.39

通期実績推移 (10月期)	FY22	FY23	FY24	CAGR	FY24(F)
売上高 (百万USD)	25,785	26,517	27,176	2.7%	29,404
売上総利益 (百万USD)	11,993	12,384	12,897	3.7%	14,151
粗利/売上高 (%)	46.51	46.70	47.46	--	48.13
営業利益 (百万USD)	7,788	7,654	7,867	0.5%	8,745
営利/売上高 (%)	30.20	28.86	28.95	--	29.74
当期利益 (百万USD)	6,525	6,856	7,177	4.9%	7,625
希薄化後EPS (USD)	7.44	8.11	8.61	7.6%	9.29
一株あたり配当 (USD)	1.02	1.16	1.44	18.8%	1.61

引用：企業公表値、ブルームバーグ（Fはブルームバーグ予想値）

*CAGRは2022年決算期を起算年とした年平均複利成長率

フィリップ証券株式会社・リサーチ部

三角友幸

TEL : +81 3 3666 0707 (直通)

E-mail : tomoyuki.misumi@phillip.co.jp

予想配当 (USD)	1.61
株価 (USD)	171.86
実績 PER (倍)	19.83
予想 PER (倍)	18.21
時価総額 (10億 USD)	141.7
企業価値 (10億 USD)	138.5
3ヵ月平均売買代金 (百万USD)	1,211.1

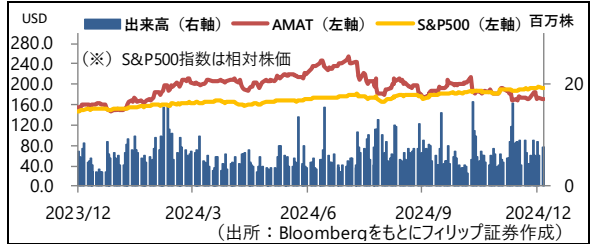
*各市場データと予想値はブルームバーグ（12/9日終値）による。

*実績PERのEPSは過去12ヶ月実績値にもとづく

会社概要

米カリフォルニアを本拠地とする世界最大級の半導体製造装置および半導体素材のベンダーである。1967年創業、1972年にNASDAQ上場。現CEOはゲイリー・E・ディッカーソン氏。

主要セグメントは①半導体工場に向けて製造・検査装置や素材を提供する『半導体システム』、②半導体工場配置や製造プロセスなどのコンサルティングを行う『アプライド・グローバル・サービス(AGS)』、③先端ディスプレイ製造装置・素材を提供する『ディスプレイ関連』。



業績詳細 (単位：百万USD)

①地域別売上(通期)	FY22	FY23	FY24	CAGR
中国	7,254	7,247	10,117	18.1%
台湾	6,262	5,670	4,010	-20.0%
韓国	4,395	4,609	4,493	1.1%
米・欧州・日本・東南アジア	7,874	8,991	8,556	4.2%

②地域別売上(四半期)	4Q23	3Q24	4Q24	ΔY/Y
中国	2,963	2,153	2,136	-27.9%
台湾	922	1,148	1,284	39.3%
韓国	745	1,102	1,172	57.3%
米・欧州・日本・東南アジア	2,093	2,375	2,453	17.2%

③セグメント別売上(通期)	FY22	FY23	FY24	CAGR
半導体システム(装置・素材)	18,797	19,698	19,911	3%
↳ファウンドリ・ロジック	12,339	15,219	13,554	5%
↳DRAM	3,594	3,332	5,610	25%
↳フラッシュメモリ	2,864	1,147	747	-49%
アプライドグローバルサービス	5,543	5,732	6,225	6%
ディスプレイ関連市場	1,331	868	885	-18%

④製品別売上(四半期)	4Q23	3Q24	4Q24	ΔY/Y
ファウンドリ・ロジック	3,369	3,545	3,779	12%
DRAM	1,318	1,182	1,191	-10%
フラッシュメモリ	195	197	207	6%

⑤キャッシュフロー・株主還元	FY21	FY22	FY23	FY24
営業キャッシュフロー	5,442	5,399	8,700	8,677
(資本支出)	(668)	(787)	(1,106)	(1,190)
フリーキャッシュフロー (FCF)	4,774	4,612	7,594	7,487
配当 + 自社株買い (総額)	4,588	6,976	3,164	5,015
総還元額 / FCF (%)	96%	151%	42%	67%

*青色字・水色字はアナリストの計算・集計による。

*図④の還元額はキャッシュフロー計算書上の数値による。

【レポートにおける免責・注意事項】

本レポートの発行元：フィリップ証券株式会社 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町4番2号

TEL:03-3666-2101 URL: <http://www.phillip.co.jp/>

本レポートの作成者：フィリップ証券 リサーチ部 三角友幸

当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。フィリップ証券は、レポートを提供している証券会社との契約に基づき対価を得る場合があります。当資料に記載されている内容は投資判断の参考としてレポートの作成者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害について、フィリップ証券も、本レポートの作成者も、責任を負いません。当資料の一切の権利はフィリップ証券株式会社に帰属しており、無断で複製、転送、転載することを禁じます。

<日本証券業協会自主規制規則「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則（平14.1.25）」に基づく表示>

・フィリップ証券または本レポートの作成者であるアナリストと対象会社との間に重大な利益相反関係はありません。